



5G高頻軟板/封測設計與模擬研討會

Agenda

上午場 高頻軟板電熱應力設計大全		
Time	Topic	Presenter
09:00-09:20	系統電路分析模擬技術與趨勢	國立高雄大學電機工程學系教授兼 先進構裝整合技術中心 - 吳松茂 教授
09:20-09:50	FPC New Generation Application	台郡科技 產品研發部 - 李威霆 副理
09:50-10:20	軟板結構設計全攻略	Ansys 資深工程師 - Chucky Chang 張學哲
10:20-10:30	交流時間	
10:30-11:00	FPC modeling for EMI and electronic thermal analysis	Ansys 技術經理 - Jerry Lai 賴穎俊
11:00-11:30	Interposer design optimization with Ansys HFSS 3D Layout & optiSLang	Ansys 技術副理 - Wayne Dai 戴偉修
11:30-12:00	軟板在電子產業之應用、需求與未來應用	新揚科技 行銷企劃處 - 洪啟盛 協理
下午場 5G毫米波封裝/測試/模組設計全攻略		
Time	Topic	Presenter
13:20-13:50	Semiconductor Package Solutions - from sub-THz AiP to HPC	ASE Corporate R&D - Alex Wang 處長
13:50-14:20	以陣列天線為例，介紹建模、分析及優化一體化設計流程	Ansys 技術專家 - Ming Chih Lin 林鳴志
14:20-14:50	Chip & Package thermal modeling	Ansys 技術副理 - Wayne Hsu 徐偉展
14:50-15:00	交流時間	
15:00-15:30	Wafer Test Probecard for 5G mm Wave devices	雍智科技 研發中心 - 戴育哲 資深協理
15:30-16:00	ANSYS Maxwell for 5G product Application	Ansys 技術副理 - Leo Kuo 郭宗男 博士
16:00-16:30	矽光子高速光電模組設計全攻略	Ansys 技術副理 - Yi-Hao Chen 陳奕豪 博士

